

コネクティブインダストリーズ

強いプロダクトと磨き上げたドメインナレッジを起点とした
フィジカルAIで、グローバルに産業分野を変革

執行役専務
コネクティブインダストリーズセクターCEO 網谷 憲晴

事業環境

技術の複雑化が加速するインダストリー領域では、「Time to Marketの短縮」「生産効率向上と品質確保」「エネルギー効率向上」「ゼロダウンタイム」といった顧客ニーズが急速に高まっています。例えば半導体の開発・製造における検証時間が約1.5倍増加し、遺伝学的検査・診断の種類が約200倍に急増するなど、技術の複雑化・高度化は加速度的に進んでおり、顧客単独での課題解決が困難であり、パートナーとの協業が不可避となっています。

このような環境下、CIセクターでは、計測装置を含めた強いプロダクトが生成する高精度なデータと、実運用を熟知したドメインナレッジにAIを掛け合わせたデジタルサービス「HMAX」で現場を自律的に最適化する「フィジカルAI」に注力していきます。CIセクターは、インダストリー領域におけるフィジカルAI事業のリーディングカンパニーをめざしており、AIへの投資が急拡大している「ファシリティ」「半導体」「医療診断」「医薬品製造」に経営資源を集中し、成長を加速しています。

Inspire 2027の進捗

2025年度は、AI需要を捉えたLumadaの力強い成長により、Lumada売上収益比率が前年度比9ポイント増の43%へ拡大、Adj. EBITA率は11.0%となりました。成長分野を見据えて前年度比で研究開発費を8%増強した中でも、ROICは前年度比0.5ポイント改善の12.0%を達成しました。特に顕著な成長を示したのが、ファシリティ^{*1}、半導体、ライフサイエンス^{*2}の3事業です。ファシリティ事業は旺盛なデータセンター需要を追い風にUPS^{*3}などの関連サービスが拡大し、売上収益は前年度比23%増となりました。半導体事業は、AI需要の拡大と顧客基盤の多角化により同26%増を達成。ライフサイエンス事業では、診断装置の出荷台数が過去最高の約1万6,000台を記録したほか、バイオ医薬品製造向けの保全事業も2023年度比で約2倍に拡大しました。

このようにInspire 2027の目標達成に向けて、事業は順調に進捗しています。今後は、「強いプロダクトを起点としたフィジカルAI事業への明確なビジネスフォーカス」「事業ポートフォリオ変革の加速」「製造業としての強みを生かしたカスタマーゼロの拡大」「グローバル事業拡大」の4点を一層加速させていきます。こうした取り組みを通じて、2027年度に、売上成長率6～8%、Adj. EBITA率13%超、ROIC 11～13%、Lumada売上収益比率約50%の達成をめざします。

^{*1} データセンター設備、昇降機、産業用HVAC、産業機器（コンプレッサー等）など、高い信頼性が要求される社会インフラ・施設向け事業領域

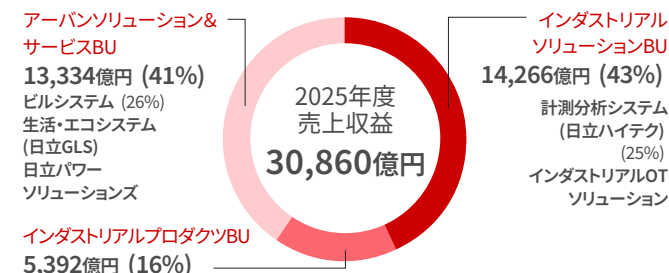
^{*2} ヘルスケア事業（診断・治療事業）＋医薬品製造事業 ^{*3} UPS: Uninterruptible Power Supply

CIセクターのめざす姿



Investor Day (コネクティブインダストリーズ事業戦略)

事業構成



インダストリアルソリューションBU

計測×デジタルによるソリューション事業の強化

- ヘルスケア (生化学免疫分析装置、細胞自動培養装置、粒子線治療システムなど)、計測・分析 (半導体製造・計測評価装置、電子顕微鏡など)
- 産業ソリューション、ロボティクスSI、産業プロセス・ユーティリティ・上下水道ソリューション

インダストリアルプロダクツBU

デジタル資産拡充に向けたプロダクト事業の拡大

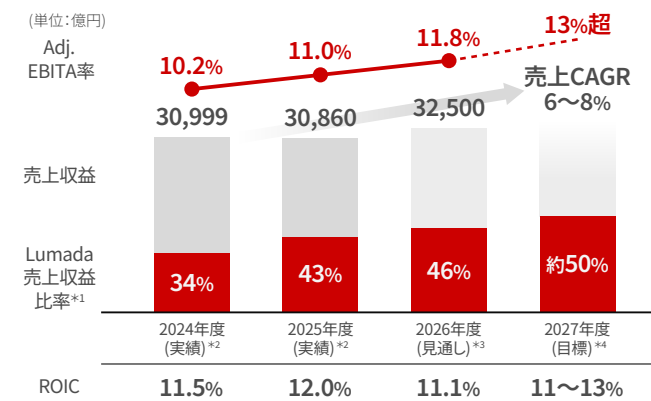
- 量産プロダクト (空気圧縮機、マーキング、受変電システムなど)
- 非量産プロダクト (プロセス圧縮機、ドライブシステム、UPSなど)

アーバンソリューション&サービスBU

ファンリティ領域におけるサービス事業の加速

- 昇降機 (エレベーター・エスカレーターなど)、ビルサービス
- 家電・空調システム
- フィールドサービス、カーボンニュートラルソリューション

業績推移／Inspire 2027業績目標



^{*1} FY2026報告セグメントから一部構造改革事業除いた売上に基づき算出

^{*2} FY2026報告セグメントに基づく ^{*3} 2026年7月29日公表 ^{*4} 2026年6月10日公表

注力領域におけるフィジカルAI事業の拡大

CIセクターは、高信頼プロダクトの豊富なインストールベースを保有している強みを生かし、フィジカルAIによる成長を実現する領域として、ファシリティ・半導体製造・診断・医薬品製造の4分野を定めています。65万台のコネクテッド昇降機、グローバルシェア約76%のCD-SEM*、グローバルシェアNo.1の生化学・免疫分析装置と遺伝子検査装置——こうしたグローバルトップクラスのデジタル化資産が生成する高精度なデータを起点として、お客さま・パートナーとの協創を通じて、AIソリューション群「HMAX Industry」を提供していきます。これにより、運用効率向上やTime to Market短縮などの顧客価値を実現し、フィジカルAI事業の拡大をめざします。

* CD-SEM: Critical Dimension-Scanning Electron Microscope

注力領域におけるフィジカルAI事業

注力領域	デジタル化資産	フィジカルAI バリュー
ファシリティ	- コネクテッド昇降機 - 空調機器 - データセンター向けUPS	HMAX for Buildings 設備運用・施設管理の最適化
半導体製造	CD-SEM	HMAX for Semiconductors 成膜・露光・エッチング工程一体での生産最適化
診断	- 生化学・免疫分析装置 - 遺伝子検査装置	HMAX for Healthcare 高精度な複数診断提供での確な治療選択と医療最適化
医薬品製造	- 分光分析装置 - 培養装置 - ラインビルド	HMAX for Biopharma プロセス立上げを起点にLabからFabまで一貫支援

さらに、日立が独自開発したエッジAI半導体もフィジカルAI事業の成長を加速する鍵となります。このエッジAI半導体は、最先端GPU比で10倍以上の電力効率を実現し、専用サーバー不要でプロダクトの知能化を可能にします。自社製品への実装による競争力強化や、協業パートナーのプロダクトへの実装を通じた協創深化、カスタマーゼロによるソリューション検証・創出加速によって、フィジカルAI事業拡大を一層加速させていきます。こうした取り組みを通じて、注力4領域のすべてにおいて市場を上回る成長を実現します。

One Hitachi — DSSセクターとの協創事例

GlobalLogicと共同で、「HMAX for Buildings」のas a Service化を実現

日立が長年培ってきたファシリティ領域でのドメインナレッジと、GlobalLogicが強みとする豊富なアジャイル開発の実績や知見を活用し、「HMAX for Buildings」のラインアップであるデジタルサービス「BuilMirai」をas a service型に発展させました。ビル設備やその保守を担うフロントラインエンジニア、ビルの利用者をつなぎ、機器や人々の活動から得られるデータを活用することで、ビルのオペレーション・メンテナンス効率やエネルギー効率、ビルに集う人々のウェルビーイングを向上させていきます。今後はこうしたOne Hitachiでの価値創造基盤をさらに拡大し、本サービスを、協創パートナーの機器や設備へつなぐとともに、一般ビルだけでなく、データセンターなどのミッションクリティカルビルにも展開していきます。

フィジカルAI事業拡大に向けた研究開発投資

フィジカルAI事業の拡大に向けたプロダクトの強化と知能化のために、研究開発投資を拡大します。「計測技術の進化」「フィジカルAIのイネーブラー強化」「プロダクトの進化」を3本柱に、2027年度までの3年累計で3,700億円の研究開発投資を行います。



フィジカルAIを軸とした事業ポートフォリオ変革

フィジカルAIを軸とした事業ポートフォリオの構築と、次なるグローバルトッププロダクトの創生を加速していきます。注力領域におけるフィジカルAI事業の拡大に向け、「計測ポートフォリオの拡充」「OTの強化」につながる重点投資を行います。また、次なる成長領域として位置づける「データセンター」「ロボティクス」「アドバンストマテリアル」「サーキュラーエコノミー」といった領域において、グローバルトッププロダクトを創生することで、フィジカルAI事業のさらなる拡大を実現します。加えて、2026年4月に発表した家電事業の再編をはじめ、各事業の強みを生かしたポートフォリオの最適化を進め、フィジカルAI事業への注力を一層加速していきます。

CIセクターの競争優位性

強いプロダクト・磨き上げたOTナレッジ

- 長年のモノづくりで培ったドメインナレッジ
- 高信頼プロダクトの豊富なインストールベース
- 世の中に存在しないデータを創出する高度な計測技術
- 複数プロダクトとデータのインテグレーション能力

フィジカルAI実装力

- データ統合・解析から現場フィードバックまでを一貫して最適化する総合力
- 顧客・パートナー協創の深化による高度なデータ活用
- カスタマーゼロによる迅速なソリューション検証・創出
- 自社開発のエッジAI半導体によるプロダクトの知能化

